

股票简称：容大感光

股票代码：300576

**深圳市容大感光科技股份有限公司
2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告**



二〇二四年六月

（本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义）

一、本次募集资金投资项目概述

本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	高端感光线路干膜光刻胶建设项目	17,591.65	12,373.00
2	IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目	10,179.75	9,695.00
3	补充流动资金	2,432.00	2,432.00
合计		30,203.40	24,500.00

注：募投建设项目预备费和铺底流动资金由公司自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）高端感光线路干膜光刻胶建设项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 17,591.65 万元，建设地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧，实施主体为公司全资子公司珠海容大。

本项目主要建设内容包括：年产 1.20 亿平方米高端感光线路干膜光刻胶项目。本项目中的感光线路干膜产品较目前干膜产品厚度更为精细，可用于半导体

引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等高精度市场。本项目建成投产后，公司将新增 1.20 亿平方米感光线路干膜产能，将有效满足公司大力拓展下游应用领域市场的业务需求，为夯实公司市场地位、保障公司未来业绩持续增长奠定基础。

2、项目实施的必要性

(1) 响应国家产业政策号召，推动干膜光刻胶产业加速升级及高端干膜实现国产突破

感光干膜是用于 PCB 制造的重要原材料。感光干膜是覆铜板图形刻蚀的关键材料，在制造加工过程中，贴合在覆铜板上的感光干膜经紫外线的照射之后发生聚合反应，形成稳定物质附着于铜板上，从而达到阻挡电镀、刻蚀和掩孔等功能，实现 PCB 设计线路的图形转移。

我国在高端干膜光刻胶产业方面，由于技术壁垒较高，并且我国产业链起步较晚，目前国产化率较低。2023 年 12 月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，将“通用型半高感 LDI 光致抗蚀干膜”（序号 98）、“封装基板用高解析度感光干膜及配套 PET 膜”（序号 239）、“封装基板用高性能阻焊”（序号 240）列入重点新材料首批次应用示范指导目录，积极推进干膜光刻胶行业的发展及产业升级，加速高端干膜光刻胶的国产突破。

公司积极响应国家产业政策的号召，积极参与并推动中高端干膜光刻胶国产化替代进程。随着下游市场对干膜需求的持续增长，更高精度、更高感度以及更高性价比的感光干膜产品迫切的国产替代需求的背景下，公司通过本次募投项目扩大干膜光刻胶产能，建设高端感光线路干膜光刻胶项目（产品对应首批次目录序号 98 及序号 239），产品将应用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等精密应用领域，有利于公司进一步布局并抢占高端感光干膜产品市场，推动干膜光刻胶产业加速升级及高端干膜实现国产突破，对于干膜光刻胶产业及国家产业链实现自主可控具有深远意义。

(2) 开拓高精度感光干膜市场，实现产品结构升级，拓展新的盈利增长点

随着下游 PCB 行业的蓬勃发展，全球感光干膜市场规模持续增长。PCB 被誉为“电子产品之母”，是电子元器件相互连接的载体，几乎是所有电子产品中不可或缺的元件，其需求受单一行业影响较小，主要受宏观经济周期性波动以及电子信息产业整体发展情况的影响。根据华经产业研究院数据显示，2021 至 2023 年全球感光干膜的出货量将由 11.91 亿平方米增长至 13.05 亿平方米，年复合增长率为 4.7%，感光干膜市场规模持续增长。根据 PrismaMark、国金证券研究所数据显示，2023 至 2027 年全球 PCB 市场规模将由 784 亿美元增长至 984 亿美元，年复合增长率为 5.8%，感光干膜约占 PCB 产业总成本的 3%，因此预计全球感光干膜的市场规模将由 2023 年的 24 亿美元增长至 2027 年的 30 亿美元。

在感光干膜市场持续增长的背景下，高精度感光干膜目前的占有率及国产化率较低。按照 PCB 下游应用领域对光致抗蚀干膜精度的要求，可分为一般商用感光线路干膜和高精度感光线路干膜。目前，在感光线路干膜的需求中仍以一般商用感光线路干膜为主，但随着电子技术的日益发达，电子芯片、电子线路板愈发精细，高精度感光干膜的应用比例不断增加，高精度、高感度、高性价比的感光干膜产品是市场需求未来发展方向。同时，一般商用感光线路干膜国产化率约 50%，而高端感光线路干膜国产化率不足 20%，随着相关产业的创新升级及产业链国产替代的需要，高端感光线路干膜存在巨大的增长空间。

公司现有主营产品已覆盖感光干膜产品，具有产品升级研发的基础。公司自 2018 年开始便组建研发团队负责该领域的技术攻关，目前，公司现有感光干膜类型主要为抗电镀干膜、精细线路干膜，分别用于普通 PCB 外层抗电镀及普通 PCB 内层抗蚀刻，具有研发高端感光线路干膜的技术基础。本次募投项目系公司为了进一步布局并抢占高端感光干膜产品市场。

在下游市场对干膜需求的持续增长，更高精度、更高感度以及更高性价比的感光干膜产品迫切的国产替代需求的背景下，公司通过本次募投项目扩大干膜光刻胶产能，建设高端感光线路干膜光刻胶项目，应用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等精密应用领域，目前已通过部分客户的验证并实现小批量供货。本次募投项目的实施，有利于公司进

一步布局并抢占高端感光干膜产品市场、持续优化提升公司产品结构，从而夯实公司市场地位及竞争力，保障公司未来业绩持续增长。

(3) 顺应进口替代的行业发展趋势，提升公司规模优势、开拓高端产品路线，提升市场开拓能力

在国家政策支持、下游市场发展、持续研发投入等因素的综合影响下，我国感光干膜光刻胶行业市场规模增长迅速。根据上市公司福斯特(5603806.SH)2021年公开披露的信息，感光干膜市场空间在百亿人民币级别。根据 PrismaMark、国金证券研究所数据显示，2023 至 2027 年全球 PCB 市场规模将由 784 亿美元增长至 984 亿美元，年复合增长率为 5.8%，则感光干膜市场规模亦将继续保持增长。PCB、半导体显示面板和集成电路产业国产化进程加速、产业链自主可控需求迫切的背景下，作为上游关键材料的干膜光刻胶呈现明显的进口替代趋势，国产干膜光刻胶或将迎来快速发展的机遇。

通过本次募投项目的实施，公司将新增 1.20 亿平方米感光干膜的自主生产产能，其中新建高端感光线路干膜光刻胶产线所生产干膜产品较公司目前的干膜产品厚度更为精细，可用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等高精度市场。本项目建成投产后，公司将新增 1.20 亿平方米感光线路干膜产能，一方面将进一步加强公司的规模优势，匹配客户日益增长的需求，另一方面将开拓高端产品线路以拓展下游客户订单、加大与现有客户的合作力度，大幅提升市场开拓能力。

3、项目实施的可行性

(1) 公司具有完备的生产体系和优质的客户资源，为募投项目的有序开展和产能消化奠定基础

公司具有完备的光刻胶产品生产体系。公司的感光干膜主要应用于半导体及 PCB 领域，客户终端产品呈现小型化、轻薄化、高性能化、多功能化趋势，因此客户会从产品质量、技术水平、生产效率、售后服务等多个角度进行严格的筛选。公司具备完善的产品质量控制体系，并通过了优质客户资源的认证。在现有完善的生产管理体系加持下，公司可有序、稳定地实现批量化生产，为项目有序开展

奠定基础。

同时，公司具有优质的客户资源。公司自设立以来，一直致力于电子化学品的研发、生产和销售，凭借产品性能的优势，公司积累了优质的客户资源。在 PCB 领域，公司拥有在业内知名的大连崇达电路有限公司、深南电路股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司、胜宏科技（惠州）股份有限公司等多家客户，与上述客户建立了长期、稳定的合作关系。本次募投项目涉及的产品之一为感光干膜，主要应用于 PCB 领域，与公司现有客户群体基本一致。

报告期内，公司一般商用感光线路干膜产品已实现量产销售。而在高端感光线路干膜产品方面，公司应用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等精密应用领域的高精度感光干膜新产品目前已通过部分客户的验证并小批量供货，并在积极推进其他重要客户的验证工作。

本项目实施后，公司将新增 1.20 亿平方米感光线路干膜产能。凭借完备的生产体系和优质的客户资源，公司具备有序建设募投项目及充分消化产能的能力，以保证项目的正常推进。

（2）产品核心技术积累深厚，为本项目实施保驾护航

公司长期致力于光刻胶产品的开发，主营产品包括 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等一系列拥有核心自主知识产权的光刻胶等。公司经过多年的自主研发和实践积累，掌握了树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等电子感光化学品核心技术。

同时，公司拥有一支经验丰富、作风严谨、创新能力强、行业技术领先的研发团队，组建了完整的产品研发、设计、工艺、质量控制的人才队伍，能够准确把握行业发展动态、积极开发新技术和新产品，为企业持续稳定发展做支撑。

公司现有主营产品已覆盖感光干膜产品，具有产品升级研发的基础。公司自 2018 年开始便组建研发团队负责该领域的技术攻关，目前，公司现有感光干膜为一般商用感光线路干膜产品，类型主要为抗电镀干膜、精细线路干膜，分别用于普通 PCB 外层抗电镀及普通 PCB 内层抗蚀刻，具有研发高端感光线路干膜的技术基础。同时，公司的高端感光线路干膜新产品已实现技术突破并研发成功，

目前已通过部分客户的验证并进行小批量供货。

因此本项目的实施具有较好的研发基础和人才储备基础，有较为成熟的技术支撑和人力支撑，在研发方面具有较高的可行性。

(3) 进口替代的行业趋势和持续政策红利，为募投项目的实施创造良好的市场条件

21 世纪以来，全球 PCB、显示、半导体产能逐渐向亚洲尤其是中国大陆转移，带动上游产业链国内需求的快速增长，行业呈明显的进口替代趋势。光刻胶作为关键电子材料，是国家战略新兴产业，最终广泛应用于消费电子、汽车、航空航天、军事装备等行业。在产业链自主可控的战略目标下，近年来，我国陆续出台多项政策促进行业发展。2023 年 12 月，发改委印发《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，将“光刻胶”等电子元器件生产专用材料列为鼓励类项目；同月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，将“通用型半高感 LDI 光致抗蚀干膜”（序号 98）、“封装基板用高解析度感光干膜及配套 PET 膜”（序号 239）、“封装基板用高性能阻焊”（序号 240）列入重点新材料首批次应用示范指导目录。公司迎来持续的政策红利。进口替代的行业趋势和持续政策红利，为本次募投项目实施创造了良好市场条件。

公司等部分国内领先企业在中高端干膜光刻胶产品研发已有一定的突破，干膜光刻胶国产化率有望进一步提升。本次募投项目实施具备广阔的市场空间和良好的外部政策环境。

4、项目投资概算

本项目总投资 17,591.65 万元，其中建设投资（不含预备费）12,373.00 万元，预备费 618.65 万元，铺底流动资金 4,600.00 万元，具体投资安排如下：

序号	投资构成	金额	占比
1	建设投资	12,991.65	73.85%
1.1	设备购置费用	12,373.00	70.33%
1.2	预备费	618.65	3.52%
2	铺底流动资金	4,600.00	26.15%
	合计	17,591.65	100.00%

注：预备费和铺底流动资金由公司自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。

5、项目建设期

本项目建设期为 2.5 年，包括产线规划、设备订购、设备安装调试、试运行等内容。

6、项目经济效益分析

经测算，本项目满产后，预计年均营业收入为 59,819.76 万元，年均税后利润为 7,200.16 万元；本项目税后内部收益率为 19.14%，所得税后静态投资回收期为 8.06 年，项目预期效益良好。

7、项目报批事项及土地情况

本项目拟建设地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧。本项目已在广东省投资项目在线审批监管平台完成备案登记，备案项目代码为 2310-440404-04-01-861680。

截至本报告公告日，本项目的环评手续正在办理过程中。

（二）IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 10,179.75 万元，实施地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧，实施主体为公司全资子公司珠海容大。

公司计划通过珠海容大实施 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目，将围绕“IC 载板阻焊干膜光刻胶”、“248nm 光刻胶关键原材料测试评估”、“248nm 厚膜正胶产品开发”、“248nm 负性 lift-off 光刻胶产品开发”、“248nm 高分辨正胶产品开发”、“248nm 光刻胶光刻工艺开发”等 6 大研发课题进行研究，旨在提升公司在 IC 载板阻焊干膜光刻胶、KrF 半导体光刻胶的研发能力，为后续丰富产品体系奠定基础，实现自身可持续发展。

2、项目实施的必要性

(1) 布局 IC 载板高端阻焊干膜领域，促进产业链国产替代、自主可控

IC 载板用阻焊干膜性能优异，是国家支持发展的材料之一。IC 载板用阻焊干膜具有优异的性能，系高端光刻胶类别之一，可作为阻焊层的应用方案，可应用于半导体领域 IC 载板生产制造，以匹配芯片封装的精细要求。相较于传统的液态型阻焊油墨，阻焊干膜不需要进行丝印（或辊涂）、静置、预烘干等工序，可以节省复杂工序，缩短工艺制程，从而提高生产稳定性及提升产品良率。IC 载板用阻焊干膜形成的阻焊层在表面平整性、开窗（PAD/SRO）精细程度、可靠性（高温高湿耐性、机械性能）等方面品质更为优越，且产品本身的环保性更为优良，能够为下游客户提供更为高效、高质量、环保的解决方案。根据工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，“封装基板用高性能阻焊”（序号 240）已列入重点新材料首批次应用示范指导目录，而 IC 载板阻焊干膜（固态）与序号 240 产品（液态阻焊）同属封装基板用高性能阻焊类产品，系国家及产业政策重点支持引导的高新技术材料。

目前阻焊干膜的国产替代化率极低，而 IC 载板用阻焊干膜更是近乎全进口，目前由日本太阳油墨公司、日本 Resonac 公司垄断，内资供应尚处于空白状态。

公司提前重点布局 IC 载板阻焊干膜光刻胶市场，以匹配下游封装基板厂商的研发、量产需求，对于促进干膜光刻胶产业链加速国产替代、实现自主可控具有深远意义。项目建成后，公司将打破高端阻焊干膜光刻胶的国外垄断局面，公司的产品矩阵亦将得以进一步拓展，有利于持续提高公司产品竞争力，推动公司长远高质量发展。

(2) 半导体下游扩产和制程升级驱动半导体光刻胶市场成长，募投项目有望填补客户对高端光刻胶的需求

在下游扩产需求旺盛、大硅片和制程升级的背景下，半导体光刻胶市场规模逐渐增加。受益于 5G、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴领域的高速成长，半导体材料市场同步保持高速增长。根据 SEMI 数据，2022 年全球晶圆制造材料市场达 447 亿美元，同比增长 10.5%。同时，随着大硅片、制程升级的趋势呈现，

单位面积晶圆所需光刻胶价值量提升。根据 SEMI、WSTS 和海通国际的数据，2022 年全球半导体光刻胶市场规模约 26.4 亿美元，预计 2030 年将增长至 45 亿美元，年均复合增长率为 6.9%。

中国半导体光刻胶的市场规模将快速增长。伴随着第三次半导体产业转移，晶圆产能向大陆转移，我国大陆地区在全球半导体材料市场占比同步提升，预计未来国内半导体光刻胶市场将保持高于全球市场的增速持续成长。根据 TrendBank 的预测，中国半导体光刻胶市场规模预计将由 2023 年的 34 亿元增长至 2026 年的 48 亿元，年均复合增长率约为 12%。

在上述背景下，公司将围绕“248nm 光刻胶关键原材料测试评估”、“248nm 厚膜正胶产品开发”、“248nm 负性 lift-off 光刻胶产品开发”、“248nm 高分辨正胶产品开发”、“248nm 光刻胶光刻工艺开发”等课题进行研究，提升自身在 KrF 半导体光刻胶的研发能力，在日趋激烈的市场竞争中保持技术先发优势，填补下游客户对国产高端半导体光刻胶的需求，实现自身可持续发展。

(3) 光刻胶是半导体制造关键材料，国产替代、自主可控需求迫切

光刻胶是半导体制造关键材料。光刻是精细线路图形加工中最重要的工艺，通常半导体芯片在制造过程中需要进行数十道光刻过程，光刻胶是光刻工艺中最重要的耗材，其质量和性能与电子器件良品率、器件性能以及器件可靠性直接相关。

目前，全球半导体光刻胶市场由日美韩厂商主导。2021 年，东京应化、JSR、住友化学、富士胶片等四家日本企业分别约占 27%、13%、12%、8% 的市场份额，美国杜邦、韩国东进分别约占 17%、11% 的市场份额，以上六家企业合计约占 88% 的市场份额。

光刻胶是半导体制造的关键材料，其自主可控的国产化替代需求迫切。为推动光刻胶等半导体材料行业的发展，国家、地方层面先后出台相关政策，2023 年 3 月，发改委等五部门联合印发《国家发展改革委等部门关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，包括光刻胶在内的集成电路产业关键原材料、零配件企业被纳入享受税收优惠政

策的清单。

公司本次半导体光刻胶研发能力提升项目响应国家支持半导体产业发展政策，有助于填补国内相关供应链的空白，加速国产化替代进程。

(4) 公司具有半导体光刻胶研发基础，升级设备可大幅提升产品研发效率

公司经过多年的自主研发和实践积累，是国内为数不多掌握光刻胶树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等制造半导体光刻胶核心技术的企业。光刻胶由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等不同性质的原料，是一种经过严格设计的复杂、精密的配方产品。随着公司产品应用领域不断拓展，公司的研发项目随之增加。目前，公司现有实验设备、检测设备已逐渐无法满足高端半导体光刻胶的研发创新需求。

为不断增强自身创新性研发能力，公司拟通过本项目购置业内先进的专业化实验设备，其中 248nm 扫描式光刻机可用于高端 DUA 光刻胶产品研发和量产检测；涂胶显影一体机可以用于 g 线和 i 线产品的研发，还可以用于 248nm 光刻胶产品的研发。

通过升级研发设备，公司可以加快项目进度和产品验证，缩短产品研发周期，为产品国产化替代创造有利条件。

3、项目实施的可行性

(1) 现有客户存在高端光刻胶产品需求，为募投项目的有序开展和产能消化提供保障

公司凭借客户提供优质产品及优质服务作为根本立足点，在行业内树立了良好的口碑，已与国内知名客户建立稳健的合作关系。IC 载板用阻焊产品方面，公司目前已实现 IC 载板用液态阻焊油墨产品的技术攻关，目前处于市场推广阶段，其在封装基板关注的 SRO 能力、undercut、BHAST 耐性等性能方面具有一定优势。而本募投项目将在液态阻焊油墨产品的技术基础上，进行液态阻焊油墨干膜化的技术研发及工艺探索。

此外，半导体光刻胶方面，公司与华微电子（股票代码：600360）、士兰微

（股票代码：600460）、扬杰科技（股票代码：300373）等半导体领域知名公司均与公司合作多年，为其提供 i 线光刻胶、g 线光刻胶等产品，且上述客户具备 KrF 光刻胶的需求。

在上述优质客户及下游需求迫切的背景下，公司积极投入资源进行相关产品的研发，通过与各下游行业领先企业的深度合作进行产品布局、积累成熟解决方案，以此形成持续的良好循环，将为阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发的有序开展及其研究成果的产能消化提供有效保障。

（2）公司具有相关产品的研发经验和专业研发管理团队，为项目顺利实施奠定基础

公司具有相关产品的研发经验。经过多年的自主研发和实践积累，公司掌握了树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等电子感光化学品核心技术。同时，在多年持续研发、工艺持续迭代和应用持续创新的背景下，公司已取得发明专利逾 40 项。公司可将丰富的技术储备广泛应用于阻焊干膜光刻胶和半导体光刻胶课题的研究，保障本项目的顺利实施。同时，公司具备专业的研发及管理团队。公司核心研发管理团队从事感光电子化学品领域产业研发工作多年，为项目实施提供重要基础。

4、项目投资概算

本项目总投资 10,179.75 万元，其中建设投资（不含预备费）9,695.00 万元，预备费 484.75 万元，具体投资安排如下：

序号	投资构成	金额	占比
1	建设投资	10,179.75	100%
1.1	设备购置费用	9,695.00	95.24%
1.2	预备费	484.75	4.76%
	合计	10,179.75	100%

注：预备费由公司自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。

5、项目经济效益分析

本项目为研发能力提升项目，不直接产生经济效益。项目建成后，将显著提升公司 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶业务的技术水平和研发能力。

6、项目报批事项及土地情况

本项目拟建设地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧。本项目已在广东省投资项目在线审批监管平台完成备案登记，备案项目代码为 2310-440404-04-01-861680。

截至本报告公告日，本项目的环评手续正在办理过程中。

（三）补充流动资金

1、项目基本情况

本次向特定对象发行股票，公司拟使用募集资金 2,432.00 万元用于补充流动资金，以满足未来业务发展的资金需求，提升持续盈利能力，优化资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。

2、项目实施的必要性和可行性

（1）满足未来业务发展的资金需求，助力公司业务扩张

公司自成立以来，一直致力于感光电子化学品的研发、生产和销售，产品主要应用于 PCB、显示、半导体等领域，并最终广泛应用于消费电子、汽车、航空航天、军事装备等行业。随着市场需求的持续增长以及公司经营规模的持续扩大，公司在业务规模扩张、技术研发投入、产品结构升级优化等方面，均需要大量的流动资金投资；同时公司在采购、生产、研发以及市场拓展等多个营运环节中资金需求迅速增加，流动资金需求较高。因此，本次公司拟使用募集资金 2,432.00 万元补充流动资金，为未来经营发展提供资金保障，助力公司业务扩张。

（2）为研发战略实施提供资金保障，提高公司的市场竞争力

光刻胶行业的技术壁垒较高，并且下游产业对产品性能要求不断提升，为持续保持公司的市场竞争力，未来公司将持续投入研究开发新产品、新技术，提高产品性能，扩充产品矩阵。本次补充流动资金有利于公司在技术研发、工艺创新、产品开发等方面持续投入，满足经营规模快速扩张带来的资金需求，从而为公司战略实施提供资金保障，提高公司的市场竞争力。

(3) 优化资本结构，增强抗风险能力

近年来，随着经营规模的不断扩张，公司资金需求持续增长，同时也导致公司资产负债率不断提高。截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 18.67%。通过本次发行补充流动资金，有利于降低资产负债率、优化资本结构，有利于公司增强抗风险能力和提高可持续发展能力。本次补充流动资金综合考虑了公司业务发展情况、现金流状况、资本结构以及预期运营资金缺口等因素，整体规模适当，具备合理性。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 对公司经营管理的影响

公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等感光电子化学品的研发、生产和销售，主要产品为 PCB 感光油墨、PCB 感光干膜、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列感光电子化学品。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，其中高端感光线路干膜光刻胶建设项目是公司顺应产业发展趋势、响应下游客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局，符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于进一步提升公司盈利能力，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目将助力公司布局相关领域，提升产品研发设计效率，加速高端 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶产品国产化突破。同时，部分募集资金用于补充营运资金将进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为经营活动的高效开展提供有力支持。

(二) 对公司财务状况的影响

本次发行是公司顺应产业发展、响应客户需求、增强竞争能力的重要战略布局。由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，因此短期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目的投产和效益的实

现，公司盈利能力和市场竞争力将不断增强，本次发行将对公司未来的财务指标产生积极影响。

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债能力，降低财务风险，为公司保持长期稳健发展奠定坚实基础。

四、结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投向符合国家产业政策及行业发展趋势，与目前上市公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划。高端感光线路干膜光刻胶建设项目有助于公司维持市场地位优势，进一步加快高端产业链的国产替代进程；IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目可以填补国内 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶的行业空白，积极响应国家集成电路行业自主可控的迫切需求。

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，将进一步完善公司的产品结构，推进公司的发展战略，有利于提高公司的核心竞争力，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票募集资金使用是必要的、可行的。

（本页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之签章页）

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日